**2023深圳国际半导体产业及应用展览会**

2023 Shenzhen International Semiconductor Industry and Application Exhibition

时间：2023年4月9-11日 地点：深圳会展中心（福华三路）

**组织机构**

展览规模：九大展馆 十万平方米

指导单位：工业和信息化部

深圳市人民政府

主办单位：中国电子器材有限公司

广东省半导体行业协会

支持单位：中国电子元件行业协会

中国电子仪器行业协会

中国电子质量管理协会

中国电子专用设备工业协会

中国电子学会通信学分会

中国半导体行业协会

中国光学光电子行业协会光电器件分会

中国光学学会激光加工专业委员会

中国真空电子行业协会

江苏省半导体行业协会

浙江半导体行业协会

陕西省半导体行业协会

上海市集成电路行业协会

天津市集成电路行业协会

大连市半导体行业协会

宁波电子行业协会

承办单位：中国电子信息博览会有限公司 深圳亚威会展有限公司

招展单位：深圳励宸国际展览有限公司

合作媒体：中国电子商情、电子技术应用、21ic 电子网、IC 交易网、Techsugar、半导体世界、半导体网城、半导体芯科技、存储在线、单片机与嵌入式系统、电子产品世界、电子发烧友、电子工程世界、集邦咨询、集微网、猎芯网、摩尔精英、我爱方案网、芯片揭秘、芯师爷、芯思想、与非网

**展会介绍**

**中国半导体产业将顺势而为，逆势崛起**

“十四五”期间，我国半导体产业将有更全面的发展，并将加快高端芯片设计等领域关键核心技术的突破和应用。随着中国对 5G、AI、IoT 和云计算、大数据等技术的大量投资，以5G网络、工业互/物联网等为代表的“新基建”将带动半导体产业的高速增长。据预测，到 2030 年我国的半导体市场供应将达到 5385 亿美元，依然为全球最大，69% 的消费量将来自中国本土公司，需求主要来自数据中心、消费电子、汽车、医疗等应用领域。

深圳在“十四五”期间要增强半导体产业自主创新能力，努力打造完备产业生态，加强前瞻性、颠覆性技术研发布局，构建深圳半导体研发中心等为主要支撑的创新平台体系，围绕国家重大生产力布局，推动先进工艺、特色工艺产线等重大项目加快建设尽早达产，加快高端芯片设计、关键器件、核心装备材料、EDA 设计工具等产业链关键环节攻关突破，加强长三角产业链协作，逐步形成综合性半导体产业集群，带动全国半导体产业加快发展。

作为全球最具规模及影响力的国际半导体领域年度盛会，“**2023深圳国际半导体产业及应用展览会**”将于**2023年4月9-11日**在深圳会展中心隆重举办，本届展会将以“国际化、专业化、高层次”的会议要求，邀请日本、韩国、美国、法国、英国、德国、芬兰等欧美地区及中国大陆/港台地区半导体产业巨头，共同探讨交流中国半导体行业之发展，本届展会是顺应产业发展的趋势，服务于十几个新兴行业应用，将邀请请AI、自动驾驶、物联网、5G通信、智能终端、智能传感等数十个新兴应用领域龙头芯片半导体企业展示新的解决方式，推动半导体产业与新兴应用市场有效结合，邀请终端大企业用户参观交流，引领设计、制造、封测、材料和设备厂商开展合作与对话，打造热门细分市场和新兴应用终端客户以及半导体产业链紧密合作交流的绝佳平台，展会同期举办多个主题二十余场专题论坛、覆盖半导体各个专业领域，为展商观众提供了最为丰富的交流机会。 通过权威论坛发布或聆听行业导向、市场趋势、技术前沿等热点话题，分享经验。

**同期活动**

2023粤港澳大湾区半导体产业趋势论坛

芯片潮下粤港湾大湾区半导体产业发展的机遇与挑战

激光图形转移技术在半导体封装中的应用

后摩尔定律时代下的先进封装分析

新兴先进半导体封装组装工艺的挑战

半导体制程工艺与装备发展的回顾和展望

大数据时代的高通途量数据处理芯片的设计发展趋势

半导体供应链生态建设论坛

中国半导体产业链重构

中国基础电子元器件产业峰会

新产品新技术发布会：IC 专场

5G 赋能工业互联网论坛

IC供应链安全发展论坛

元宇宙生态发展大会

半导体技术装备国产化发展大会

**展览会亮点**

1.覆盖半导体领域全产业链，聚焦行业应用，为制造商提供新思路及解决方案，终端买家精准对接。

2.依托深圳电子展资源带来强大科研购买力，汇聚高校，科研院所，重点实验室，工程中心，技术开发机构。将技术推向市场，帮助企业提升技术创新能力，解决新产品开发的关键技术，全新科技服务模式助力科技成果转化及产业升级。

3.将技术推向市场，帮助企业提升技术创新能力，解决新产品开发的关键技术，全新科技服务模式助力科技成果转化及产业升级。

4.高端论坛聚焦前沿，论坛水准及规模得到业内极大认可，内容覆盖半导体、5G技术、芯片技术、人工智能、智能家居、智能制造、物联网、智能驾驶、车联网、5G商用、8K超高清、区块链技术、新一代信息技术、大数据、云计算、应急安全、光电显示等。来自不同行业专业听众将带来各种应用需求。

**观众来源**

1. 航空航天，船舶制造，汽车工程，仪器设备工程技术，通用工程技术，电子电气行业，IT产业，通讯行业，医疗，化工，石油煤炭、能源、冶金、家电及消费电子（手机、穿戴、移动产品、VR/AR）、汽车电子、物联网应用、智能家居、智慧养老、智慧城市、物联网应用、高端装备、智能制造、机器人、无人机、工业自动化、军工电子、轨道、交通、能源化工、5G通信、机器人机床等。

2、国家级科研院所、高校、研发机构、行业协会、产业联盟、工业园区、高新区、产业基地、孵化器机构等。

3、国家有关部委及各省市政府、各驻中国商会、行业协会商会、进出口贸易公司、投资机构等

**日常安排**

报到布展：2023年04月7-8日（09：00—17：00） 开幕时间：2023年04月9日（09：00）

展出时间：2023年04月9-11日（09：00—16：30）闭幕时间：2023年04月11日（16：00）

**展览范围**

1、半导体设计、封测、制造产厂商。

2、原材料：硅晶圆、硅晶片、光刻胶、光掩膜版、电子气体及特种化学气体、CMP抛光材料、光阻材料、湿电子化学品、溅射靶材、封测材料；

3、生产设备：单晶炉、氧化炉、扩散设备、离子注入设备、PVD、CVD 、光刻机 、 蚀刻机 、抛光机、倒角机、涂胶/显影机、前道测试设备、湿制程设备、热加工、涂布设备 、单晶片、沉积系统、清洗设备；

4、封装工艺及设备：减薄机、划片机、贴片机 焊线机、塑封机、打弯设备、分选机、测试机、机器人自动化、机器视觉、其他材料和电子专用设备等：

5、测试与封装配套产品：探针卡、引线键合、烧焊测试、自动化测试、激光切割及其它、研磨液，划片液、封片膜(胶)高温胶带、层压基板、贴片胶、上料板，焊线、流量控制、石英石墨、碳化硅等；

6、IC 产品与应用技术、IC 测试方法与测试仪器、IC 设计与设计工具、IC 制造与封装；

7、电子气体：集成电路、平面显示器件及其它电子产品生产的特种气体企业；

8、半导体分立器件产品、半导体光电器件、集成电路终端产品；

9、人才招聘展区

**参展收费标准**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **展位价格** | **类别** | **国内参展商** | **双开展位** | **境外参展商** |
| 标准展位（9平方） | 15000元/个 | 16500元/个 | 2520美元/个 |
| 光地（36㎡起租） | 1500元/㎡ | 1500元/㎡ | 260美元/㎡ |

**参展流程**

1、展位安排原则：“先申请、先付款、先安排”。

2、为使本届展会整体安排更趋合理化、国际化请认真填写参展申请及合约书表并加盖公章传真或邮寄至大会组委会

3、参展单位报名后须在五个有效工作日内支付50％参展费用定金，否则大会组委会有权调整或取消其所定展位

4、未经大会组委会同意，参展企业单方面取消参展计划，其已付参展费用不予退还

**联系我们 丨**

如欲订展位和了解更多信息，请通过以下联络方式：

邮箱：zsbwangping@vip.163.com

Q Q：1045470153

联系人：王平 18602112420（同微信）

地址： 深圳市南山区桃源街道平山社区丽山路10号创业园